



特長

- 1 MOLEX社「Mirror Mezz」正式セカンドソース
- 2 高速伝送対応 (56+Gbps NRZ / 112+Gbps PAM4対応)
- 3 OAM標準接続コネクタ
- 4 多芯高密度設計 : 688芯 (cm²スペース当たり26差動ペア実装)
- 5 雌雄同体設計
- 6 スタブレス2点接点構造
- 7 端子先端をハウジングで保護し、嵌合時の座屈を防止



High-Speed



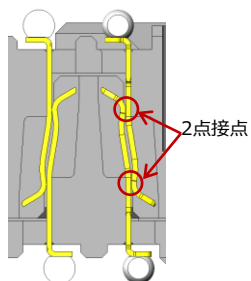
Low Profile



Stacking

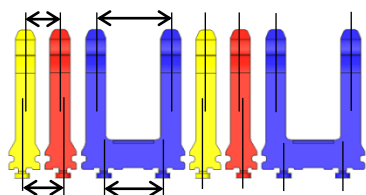
端子構造

スタブレス構造



- ・優れたSI性能
- ・2点接点構造で信頼性向上
- ・ワイピング量 : 最大1.5mm

インピーダンスマッチング (92Ωターゲット)

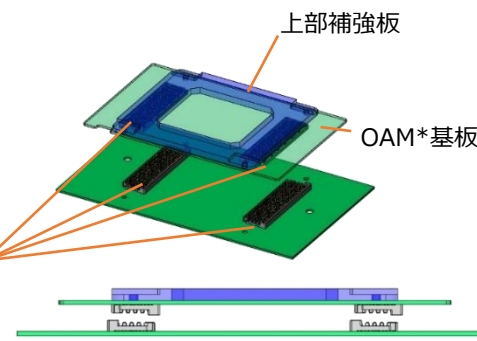


接触部と実装部のピッチを変え、
インピーダンスを最適化

OAM (OCPアクセラレータモジュール) に採用



IT14:
5mmスタッキングハイト
(2.5mm + 2.5mm)
688芯
172差動ペア



仕様

定格電流	1.2A
定格電圧	30V AC/DC
使用温度範囲	-55 ~ +105°C
接触抵抗*	30mΩ 以下
耐電圧	500V DCで1分間
絶縁抵抗	1000MΩ (500V DC)
挿抜回数	100回
インピーダンス	92Ω

*導体抵抗を含む。

-MOLEX社「Mirror Mezz」とクロス嵌合可能。
-芯数 : 688芯

*OAM = OCP (Open Computer Project) アクセラレータモジュール